日本 MID 協会 定例会のご案内

主催:日本 MID 協会

拝啓 秋冷の候,ますます御健勝のこととお慶び申し上げます. 日頃は大変お世話になっております. 本協会は下記の要領で2014年度の定例会を開催しますので,ご参加の程よろしくお願い致します.

今年は、MID に関連する様々な企業の講演に加え、付加製造(3D プリンティング)やプリント配線板の動向に関する特別講演を行います。また9月24日~26日にドイツで開催される11th International Congress Molded Interconnect Device(主催;ドイツ 3D-MID 協会)の報告も行います。併せてポスター展示も昨年同様実施します。

定例会終了後には、参加者相互の親睦を深めるため懇親会(有料)も行いますので、こちらも是非ともご参加ください.

関連部署へのご紹介,ご回覧の程宜しくお願い申し上げます.

敬具

記

日 時 2014年11月7日(金) 10時より(受付開始9時30分)

場 所 東京大学 生産技術研究所(駒場リサーチキャンパス) An 棟 2F コンベンションホール 東京都目黒区駒場 4 丁目 6 番 1 号

参加費 定例会(予稿集,昼食を含む)

- 10月23日(木)まで ; 会員企業の方4,000円, 非会員 8,000円 ※延長しました

- 10月24日(金)以降 ;会員企業の方5,000円, 非会員10,000円

懇親会

- 10月23日(木)まで ;4,000円(会員・非会員問わず) ※延長しました

- 10月24日(金)以降 ; 5,000円(会員・非会員問わず)

※ポスター展示参加企業につきましては、1名様を懇親会に無料でご招待します.

無料の方は、申込書にチェックをお願いします.

申込先 Email: secretary@jmid.gr.jp (FAX 番号は昨年より廃止しました)

事前申込締切日 2014 年 10 月 10 日 (金) 2014 年 10 月 23 日 (木) ※延長しました

※予稿集や昼食の手配の都合上、なるべくこの日までのお申込みをお願いします.

振込先 みずほ銀行 久が原支店(振込手数料はご自身でご負担お願いします)

口座名:「ニホンエムアイデーキョウカイ」 口座番号:(普)1089275

<プログラム>

開会挨拶 10:00~10:05					
特別講演1	付加製造(3Dプリンティング)の現状				
10:05~11:20	東京大学 生産技術研究所 機械·生体系部門 教授 新野 俊樹 氏				
講演 2	SKW-3D-MID の最新動向				
11:20~11:45	三共化成(株) 技術部 安達 健之 氏				
講演 3	LPKF-LDS パウダーコーティングの紹介				
11:45~12:10	LPKF Laser & Electronics (株) マネージャ 沼 博之 氏				
昼食 12:10~13:10 (ポスター)					
特別講演 4	プリント配線板の歴史にみる進化と最近の技術の動き				
13:10~14:25	NPO サーキットネットワーク,髙木技術士事務所 髙木 清 氏				
講演 5	11th International Congress Molded Interconnect Device 参加報告				
14:25~14:50	LPKF Laser & Electronics (株) テクニカルセールスエンジニア 上舘 寛之 氏				

講演 6	LDS 向け射出成形用材料の紹介				
14:50~15:15	三菱エンジニアリングプラスチックス(株) 第1事業本部 技術部 TS グループ				
	研究員 菊地 達也 氏				
休憩 15:15~15:45 (ポスター)					
講演 7	LDS プロセスにおけるファインピッチめっきへの取り組み				
15:45~16:10	日本マクダーミッド(株) 技術本部 エレクトロニクス課 渡邉 歳哉 氏				
講演 8	モジュール型汎用自動動組立装置 SmartFAB による 3D-MID 実装の現状と課題				
16:10~16:35	16:10~16:35 富士機械製造(株) FA 開発部 設計課 シニアリーダ 濱根 剛 氏				
講演 9	講演 9 円筒形成形物の内側表面に成膜される銅薄膜のパターニング				
16:35~17:00 東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻 宮川 裕史 氏					
閉会挨拶 17:00~17:05					
懇親会 17:15~19:15 (ポスター)					

<ポスター>

LPKF Laser & Electronics (株), 奥野製薬工業(株), 三共化成(株), (株) ジャパンユニックス, DSM Japan エンジニアリングプラスチックス(株), 日本マクダーミッド(株), パナソニック(株), 富士機械製造(株), 三菱エンジニアリングプラスチックス(株), ロームアンドハース電子材料(株) (全 10 社, 50 音順)

○注意事項

- ・講演会場内での飲食(ペットボトルのお茶などを含む)は禁止です.
- ・昼食として弁当を用意しています. 昼食会場は当日ご案内致します.
- ・最新情報は日本 MID 協会のホームページ (http://www.jmid.gr.jp) でご確認下さい.

○会場へのアクセス

場 所 東京大学 生産技術研究所(駒場リサーチキャンパス) An 棟 2F コンベンションホール 東京都目黒区駒場 4 丁目 6 番 1 号

最寄駅 井の頭線 駒場東大前駅より徒歩10分,池ノ上駅より徒歩10分 (いずれも各駅停車のみ)

小田急線/東京メトロ千代田線

東北沢駅(小田急線各駅停車)より徒歩7分,代々木上原駅より徒歩12分

						-		
※アクセスマップ	http://www.i	is.u	-tok	tyo. a	c.jp	/acce	ess/access.html	
※キャンパスマップ	http://www.i	is.u	-tok	tyo. a	c.jp	/acce	ess/campusmap.html	
								以上
		切	り	取	り	線	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
日本 MID 協会事務局宛								
Email: secretary@imid	.gr.ip							

2014年11月7日 日本 MID 協会 定例会 参加申込書

会員種別;会員・非会員 懇親会 ;参加・不参加		□ポスター参加企業の無料招待者(1名)
貴社名		住所〒
所属		ご氏名
TEL		FAX
E-mail		